

# 주요 경쟁사 동향

2003.4.21 ~ 26

소니	◆ 소니-도시바, 광대역 게임기용 칩에 집중 투자 · 향후 3년간 총 5천억 엔(42億 달러)
도시바	◆ 大分に 300mm 웨이퍼 신공장 건설 · 04년도 상반기 후반부터 생산 ◆ 일본 전자업계, 동맹 해산
인텔	◆ 인도에 R&D센터 · 04년 4월 위
후지쯔	◆ 기존 光 신호 재생 실현 · fiber망에서 실용화 지향
마쯔시타	◆ ETC기용 재기용 소형 칩 개발 · 03년 말에 월간 10만개 양산 계획
기타 경쟁사	◆ 노키아, 한국 시장 재진출 외

## □ SONY

### ◆ 소니-도시바, 광대역 게임기용 칩에 집중 투자

- 차세대 게임기용 반도체 생산, 대폭 확대 계획
  - 향후 3년간 총 5천억 엔(42억 달러) 투자
  - 금번 투자로 반도체 구입 비용 대폭 감소 예상
- 게임과 영화, 출판, TV를 광대역 망으로 결속할 야심
  - 계열사인 소니 컴퓨터 엔터테인먼트(SCEI)와 공동 투자
  - 신 마이크로프로세서 및 기타 시스템 LSI 생산

<연합뉴스 2003-4-26>

## □ 도시바

### ◆ 대분에 300mm 웨이퍼 신 공장 건설

- '03년 6월부터 건설, 04년도 상반기 후반부터 양산.
  - 투자 총액 : 약 2000억 엔,
  - 03년도 투자 : 약 400억 엔
  - 풀 가동 시, 월 생산 1만 2500매 규모
- 65nm 공정기술을 사용한 300mm 웨이퍼를 생산
  - 브로드 밴드 대응 프로세서를 중심으로 생산
- 차세대 게임기용 프로세서 공급 계획
  - SCE와 공동으로 제조 장치 설치 및 생산.

<일간공업신문 2003-04-22>

◆ 일본 전자업계, 동맹 바람

- 도시바-미쓰비시전기; 산업용 전기장비와 자동화시스템 사업부문 통합
  - 50대 50의 지분 비율로 조인트 벤처 설립 계획
- 소니-도시바; 현재 착공을 앞두고 있는 도시바의 신규 반도체 생산시설에서 소니의 게임용 반도체 생산 위해 상호협력
  - 소니는 핵심부품의 반도체 기술을, 도시바는 신규공장 투자비용 확보
- 히타치제작소-미쓰비시전기; 세계 3위의 반도체 업체 목표로 반도체 합작벤처 르네사스 테크놀로지 출범('02년 12월)

<디지털타임스 2003-4-22>

□ 인 텔

◆ 인도에 R&D센터 건설 계획

- 인도 남부 방갈로르 지역에 연구개발(R&D) 센터 건립 계획
  - '03년 5월 ~ '04년 3월
  - 기존 시설에 대한 설비확장, 총 4100만 달러 투자
- 2007년까지 최고 2억 달러를 투자, 최고 3천명의 인력 고용 설

<전자신문 2003/04/24>

## □ 후지쯔

### ◆ 기존보다 16배 이상 빠른 광 신호 재생 실현

- 독일 Heinrich Hertz연구소와 공동으로  
차세대 장거리 대용량 통신 기초 기술 개발
  - 신호를 전기로 변환하지 않고 광 신호 그대로 처리
  - 종래보다 16배 빠른 매초 160기가 비트의 신호를 재생, 실현
- 2006년을 목표로, 북미나 중국용 기간 fiber망에서 실용화 지향

<일경산업신문 2003-04-24>

## □ 마츠시타

### ◆ ETC차량 탑재기용 소형 칩 개발

- 자동 요금 수수 시스템(ETC)차량 탑재기용 무선용 1칩 IC 「AN18420A」 개발
  - 광범위한 주파수 특성과 고집적화 양립
- 고속도로 요금소에서 차량의 논스톱 장치의 보급에 기대
  - 03년 말에 월간 10만개 양산 계획

<일간공업신문 2003-04-22>

## □ 기타 경쟁사

### ◆ 샤프, 액정 모니터 신규 용도 개척

- 현재, 출하의 대부분인 PC용 수요는 수년 내에 한계점 도달 예상.
  - PC이외의 신규 용도 개발 한창
- 산업기기(FA기기, POS단말 등) 외에, 의료기기에서의 이용을 예상하고 단말로 조합한 액정 모듈과 터치 패널식 모니터 확장 판매 중.
- 2004년도 모니터 출하를 100만대 이상으로 배증하고, 신규용도가 차지하는 비율을 27%로 높일 계획

<일경산업신문 2003-04-23>

### ◆ 샤프, 주택용 태양광 발전 모듈 발매

- 주택용 양산품으로는 업계 최고인 태양광 발전모듈 「NT 167AK」 발매
  - 모듈당 최대 출력 167와트로 변환효율 17.4%
  - 단결정 실리콘 태양전지 채용, 전류 손실저감 등으로 변환효율 높임
  - 모듈 설치면적 기존 다결정 실리콘 태양전지 모듈 대비 약 25% 작음

<일간공업신문 2003-04-22>

### ◆ 시스코, 이동 단말기 시장 진출

- 초고속 인터넷(WiFi) 휴대폰 개발, 오는 6월 첫 제품 출시 계획
  - 음성 및 데이터 겸용 전화기를 이동통신망에서 사용할 수 있도록 개발
- 휴대폰에서 이더넷 수준의 초고속 데이터 통신 가능

- 차세대 IT로 떠오르는 VoIP와 WiFi를 휴대폰에서 통합

<전자신문 2003-4-22>

◆ **노키아 한국 시장 재진출**

- 유럽식 GSM 단말기로 틈새 시장 진출 추진
  - 해외여행자를 대상으로 일본시장에서도 큰 성과
- WCDMA 단말기 공급, 비동기방식의 3세대 휴대폰 시장의 선점도 계획
  - 국내 업체의 주춤한 시장공략에 기술력으로 선점하려는 의도

<전자신문 2003-04-21>